

UF 158LA 底部填充胶 产品数据表

卓越的耐热循环性能

优异的抗机械冲击性能

高良率

简介

UF 158LA 是一种快速流动、低温慢固化、高纯度的液态环氧底部填充材料。该材料适用于倒装芯片及晶圆级芯片尺寸封装等应用。UF 158LA 同样适用于存储卡、芯片载体、混合电路、多芯片模块等多种先进封装中的裸芯片保护。其设计面向高产能、环保型制造环境, 在制程速度和抗机械冲击性能为关键考量的应用中表现突出。该材料易于点胶, 可有效降低封装过程中引入的应力, 在可靠性(如温度循环性能)及机械抗冲击性能方面表现优异。

物理特性

产品名称	UF 158LA 液态底部填充胶
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.8 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	5 – 8.0 kcP
固化材料特性	
Tg (ASTM D3418-82)	145 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	$\alpha_1 = 22$; $\alpha_2 = 112$
剪切强度 (FR4 / FR4)	3800 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

在 150 °C 条件下固化 1 小时。可根据客户需求, 提供并评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下, 若材料存放于密封的原始包装容器中, 保质期为 6 个月。超过该期限存放, 产品粘度可能会升高。储存时应避免 水分侵入、挥发及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全

UF 158LA 为环境友好、无毒材料。在操作和使用过程中, 仍建议遵循常规的工业卫生操作规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SDS(安全数据表)。

包装

UF 158LA 毛细管底部填充系列产品提供 5 cc、10 cc 和 30 cc 三种规格。其他规格可依客户要求客制化。请联络 YINCAE 以取得订购资讯。